

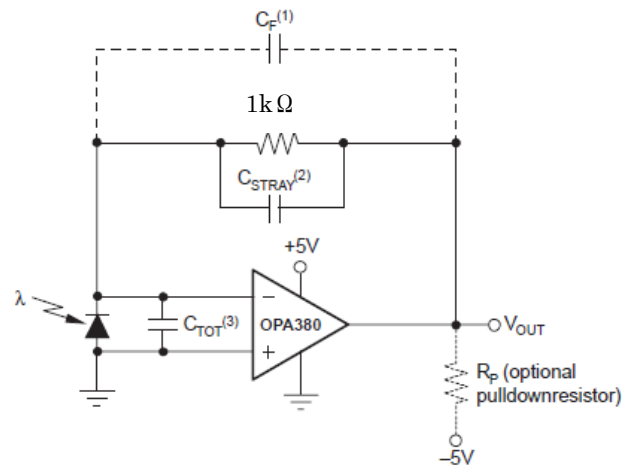
研究報告

1. 先週の目標

OPA380 の性能試験のため、プリント基板に用いる回路を設計する。

2. 回路の設計

使用ソフト DesignSpark PCB by RS Components



注記：(1) C_F はオプションであり、ゲインのピーキングを防止します。
 (2) C_{STRAY} は R_F の寄生容量です(表面実装型抵抗で一般に0.2pF)。
 (3) C_{TOT} はフォトダイオード容量+OPA380の入力容量です。

図 1 インピーダンスアンプ回路

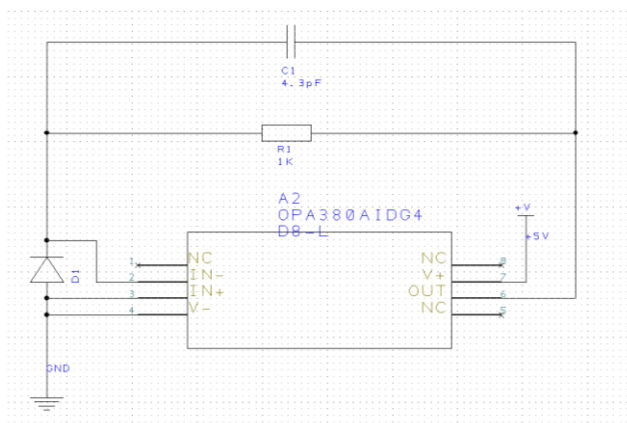


図 2 プログラム上の回路図

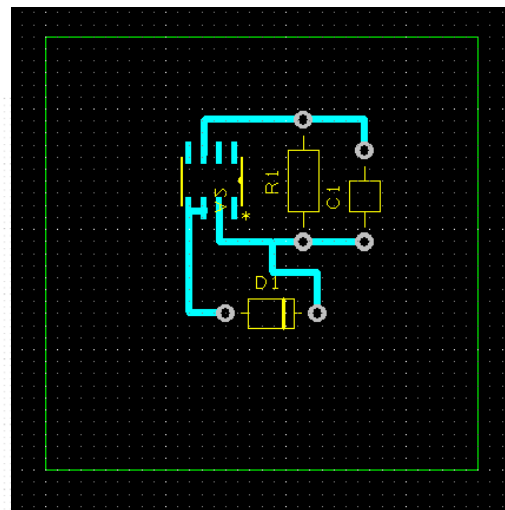


図 3 プリント基板用回路図

3. 今週の目標

プリント基板用回路図の完成&プリント基板の試作